

# RAITECH® FLUORO:GRAF® 2.5+

PTFE / Grafito = FLUORO:GRAF® 2.5+



RAITECH

HEXA GRAF

FLUORO:GRAF MASTER

## Fluidos comunes:

- Soluciones cáusticas.
- Ácidos y bases fuertes (excepto ácido nítrico fumante y flúor).
- Alcoholes.
- Cetonas.
- Esteres.
- Aceites Sintéticos.
- Agua de torre de enfriamiento.

## Equipos comunes:

- Bombas centrífugas de alta velocidad.
- Mezcladores.
- Agitadores.
- Reactores.
- Válvulas.

Página 1/1

Ficha Técnica.



Aplicaciones Demandantes.  
+ Densidad.  
+ Disipación.  
+ Sellabilidad.

## DATOS TÉCNICOS

Propiedades:	FLUORO:GRAF® 2.5+	Empaquetadura
Composición:	FLUORO:GRAF® 2.5+ (PTFE / Grafito), Mejorada disipación de calor.	
Temperatura Máxima:	280 °C	
Temperatura Mínima:	-200 °C	
Presión Máxima, Rotativos:	30 bar	
Presión Máxima, Reciprocantes:	140 bar	
Presión Máxima, Válvulas:	200 bar	
Velocidad Periférica:	25 m/s	
Rango pH:	0-14	

\*\*Los valores máximos de temperatura y presión no deben ocurrir simultáneamente.

## PRESENTACIONES:

Presentaciones:	FLUORO:GRAF® 2.5+	Empaquetadura
1/8", Caja: 2.3kg:	55	mt / kg
3/16", Caja: 2.3kg:	22.4	mt / kg
1/4", Caja: 2.3kg:	13.5	mt / kg
5/16", Caja: 2.3kg:	10	mt / kg
3/8", Caja: 2.3kg:	5.8	mt / kg
7/16", Caja: 2.3kg:	4.8	mt / kg
1/2", Caja: 2.3kg:	3.3	mt / kg
9/16", Caja: 2.3kg:	2.7	mt / kg
5/8", Caja: 5kg:	2.1	mt / kg
3/4", Caja: 5kg:	1.5	mt / kg
7/8", Caja: 5kg:	1.2	mt / kg
1", Caja: 5kg:	1	mt / kg
<b>Tolerancia Espesor:</b>	<b>±10 %</b>	
<b>Notas:</b>	El producto empaquetado puede tener una variación de ±10%	
	*Otras medidas milimétricas y de mayor sección, bajo cotización.	

El nuevo nombre de alto desempeño.  
Mayor disipación de calor y sellabilidad mejorada.

Empaquetadura de construcción inter-trenzada a partir de filamentos **FLUORO:GRAF® 2.5+** basados en PTFE íntimamente mezclados con partículas de grafito en una proporción de alto desempeño que le confiere a la empaquetadura una mayor sellabilidad y vida útil.

La empaquetadura **FLUORO:GRAF® 2.5+** es capaz de resistir la mayoría de los productos químicos dentro del rango de pH 0-14 (con la excepción metales alcalinos fundidos y flúor elemental)

Resiste temperaturas desde -210°C hasta +280°C. A su vez puede trabajar en aplicaciones de altas velocidades de hasta 25m/s gracias a los aditivos minerales de alta temperatura auto-lubricantes.

**FLUORO:GRAF® 2.5+** esta diseñada específicamente para entornos de alta velocidad donde el control de la temperatura es crítico:

- **Industria de Papel y Celulosa:** Bombas de licor negro, blanco y verde.
- **Procesamiento Químico:** Manejo de ácidos, álcalis, solventes y químicos agresivos.
- **Minería y Dragado:** Bombas de lodos y transferencia de fluidos abrasivos (en combinación con anillos de fondo).
- **Plantas de Energía:** Bombas de condensado y sistemas de tratamiento de agua.

### Ventajas Competitivas:

- **Disipación de Calor:** la concentración grafito integrado reduce drásticamente la temperatura en la interfaz eje-empaquetadura, evitando que el PTFE se cristalice.
- **Bajo Desgaste del eje:** El material es lo suficientemente suave para no desgastar camisas de eje costosas, pero estructuralmente firme para resistir la extrusión.
- **Eficiencia Energética:** Su bajísimo coeficiente de fricción reduce el amperaje necesario para el arranque de los motores.
- **Estanqueidad Superior:** Al ser PTFE expandido, posee una memoria elástica que sella micro irregularidades con menor torque de apriete.

\*Nota: No se recomienda su uso en medios altamente oxidantes, ácido nítrico humeante, agua regia, flúor gaseoso, tintas y barnices.

www.raitech.mx

RAIPACK®

Toda la información técnica y las recomendaciones dadas en este documento son en base a nuestra experiencias, Sin embargo, no aceptamos cualquier tipo de responsabilidad. Los datos y valores presentados deben ser revisados por el usuario, partiendo de que el éxito en el sellado solo puede darse evaluando todos los parámetros y variables directamente en el sitio de trabajo. Los parámetros en este documento son aproximados y pueden tener influencia mutua si ocurren simultáneamente, póngase en contacto con nosotros en aplicaciones críticas o donde exista duda.